

证券代码:1002213

证券简称:大为股份

公告编号:2024-077

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议、2024年6月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司提供担保额度,予子公司之间互相提供担保额度不超过1380,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度不超过100,000万元。在上述担保额度内,公司及控股子公司业务经营需要,原则上上述担保范围业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等,担保种类包括授信、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会重新审议为公司业务融资提供担保额度之前。

详情参见公司于2024年4月26日、2024年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-022)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-028)及相关公告。

二、担保进展情况

(一)2024年12月3日,公司披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》,公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称“大为创芯”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行深圳分行”)签订了《综合授信协议》(编号:ZJH3142409002)及《流动资金贷款合同》(编号:ZJH3142409002)。上述授信额度为人民币1,000万元,贷款金额为人民币100万元,贷款期限为2024年11月29日至2025年11月28日;公司向光大银行深圳分行签订了《最高额保证合同》(编号:GB39142410002),为上述融资行为提供连带责任保证,担保的主债权本金最高额为人民币1,000万元。公司全资子公司深圳市芯汇群科技有限公司(以下简称“芯汇群科技”)与光大银行深圳分行签订了《综合授信协议》(编号:ZJH3142411001)及《流动资金贷款合同》(编号:ZJH3142411001)。上述授信额度为人民币1,000万元,贷款金额为人民币100万元,贷款期限为2024年11月29日至2025年11月28日;公司向光大银行深圳分行签订了《最高额保证合同》(编号:GB39142411001),为上述融资行为提供连带责任保证,担保的主债权本金最高额为人民币1,000万元。详情参见公司于2024年12月3日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-073)。

近日,大为创芯与光大银行深圳分行签订了《流动资金贷款合同》(编号:ZJH3142409002)及《最高额保证合同》(编号:ZJH3142409002)项下的额度内放款人民币900万元,贷款期限为2024年12月25日至2025年12月23日。芯汇群科技与光大银行深圳分行签订了《流动资金贷款合同》(编号:ZJH3142411001-2UK),在上述《综合授信协议》(编号:ZJH3142411001)项下的额度内放款人民币900万元,贷款期限为2024年12月24日至2025年12月23日。

(二)近日,公司与江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“江苏银行深圳分行”)签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司大为创芯在江苏银行深圳分行人民币1,000万元综合授信额度提供最高额连带责任保证,担保最高债权额为最高债权本金人民币1,000万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

(三)近日,大为创芯与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“中国银行罗湖支行”)签订了《授信额度借款合同》《流动资金借款合同》,授信额度为人民币1,000万元,借款金额为人民币1,000万元,借款期限为2024年12月27日至2025年12月27日;公司与中国银行罗湖支行签订了《最高额保证合同》,为上述融资行为提供连带责任保证,担保的主债权本金最高额为人民币1,000万元。

上述融资行为经公司董事会于2024年第十一次会议、2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)深圳市大为创芯微电子科技有限公司
1.名称:深圳市大为创芯微电子科技有限公司
2.成立日期:2011年3月23日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:3,000万人民币

6.主营业务:半导体电子产品测试、晶圆测试、半导体电子产品生产加工及销售(凭深惠保税B1213400019号批文);集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子元器件及软件技术开发;国际贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

7.股权结构

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.81	94,526,326.72
净资产	45,233,533.08	43,656,793.91
项目名称	2024年11月1日财务状况(未经审计)	2023年11月1日财务状况(经审计)
资产总额	617,108,303.16	629,704,176.84
负债总额	134,019,786.18	122,871,903.26
净资产	3,980,480.64	35,526,869.69

10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

(一)深圳市芯汇群科技有限公司

1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
2.成立日期:2015年6月11日
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

4.法定代表人:连浩淼

5.注册资本:100万人民币

6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可开展经营活动)。

项目名称	2024年9月30日财务状况(未经审计)	2023年12月31日财务状况(经审计)
资产总额	185,590,327.89	138,183,186.63
负债总额	140,356,794.	